(12)特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2004 年1 月29 日 (29.01.2004)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 2004/010499 A1

(51) 国際特許分類[7]: H01L 23/28

(21) 国際出願番号: PCT/JP2003/007598

(22) 国際出願日: 2003 年6 月16 日 (16.06.2003)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:
特願2002-210750 2002 年7 月19 日 (19.07.2002) JP

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 松下電器産業株式会社 (MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO., LTD.) [JP/JP]; 〒571-8501 大阪府 門真市 大字門真１００６番地 Osaka (JP).

(72) 発明者; および
(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 恒岡 道朗 (TSUNEOKA,Michiaki) [JP/JP]; 〒567-0821 大阪府 茨木市末広町 4－２０ Osaka (JP). 橋本 興二 (HASHIMOTO,Koji) [JP/JP]; 〒658-0021 兵庫県 神戸市東灘区深江本町 １－１３－２６ Hyogo (JP). 葉山 雅昭 (HAYAMA,Masaaki) [JP/JP]; 〒631-0817 奈良県 奈良市西大寺北町 １－６－１３－９０４ Nara (JP). 安保 武雄 (YASUHO,Takeo) [JP/JP]; 〒572-0051 大阪府 寝屋川市 高柳５－４８－１２ Osaka (JP).

(74) 代理人: 岩橋 文雄, 外 (IWAHASHI,Fumio et al.); 〒571-8501 大阪府 門真市 大字門真１００６番地 松下電器産業株式会社内 Osaka (JP).

(81) 指定国 (国内): CN, SG, US.

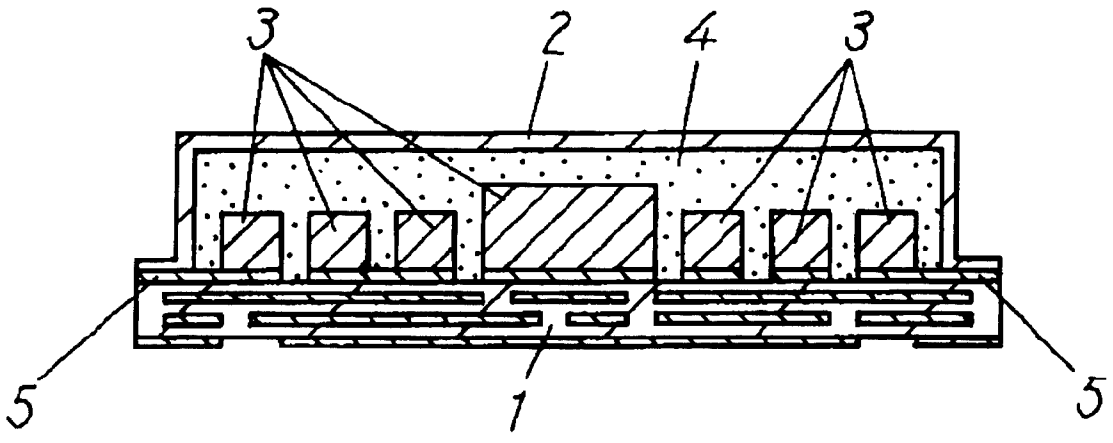
(84) 指定国 (広域): ヨーロッパ特許 (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR).

添付公開書類:
— 国際調査報告書

２文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

(54) Title: MODULE COMPONENT

(54) 発明の名称: モジュール部品



(57) Abstract: A module component comprises a mount part, a circuit board on which the mount part is mounted, a first ground pattern provide on the peripheral region of the surface of the circuit board, a first sealing body provided on the circuit board, having a projected area on the circuit board smaller than the area of the profile of the circuit board, formed of a first resin, and adapted to seal the mount part, and a metal film covering the surface of the sealing body and connected to the ground pattern. The module component has a low height and exhibits a sufficient shielding effect.

(57) 要約: モジュール部品は、実装部品と、実装部品を搭載した回路基板と、回路基板の表層面の最外周に設けられた第１のグランドパターンと、回路基板上に設けられて、回路基板への投影面積が回路基板の外形より小さく、第１の樹脂で形成されて実装部品を封止する第１の封止体と、封止体の表面を覆い、グランドパターンに接続された金属膜とを備える。このモジュール部品は低背で十分なシールド効果が得られる。

WO 2004/010499 A1